**企业技术难题及合作意向表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **企业名称** | 中芯国际 | | |
| **详细地址** | 北京经济技术开发区文昌大道18号 | | |
| **意向合作中科院单位** | |  | |
| **所属产业类别** | □新一代信息技术产业 □新能源汽车与智能网联汽车产业 □生物技术与大健康产业 □机器人与智能制造产业 √其他，请说明 集成电路 | | |
| **企业简介** | 中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国内地技术最先进、配套最完善、规模最大、跨国经营的集成电路制造企业，提供0.35微米到14纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务，包括逻辑芯片，混合信号/射频收发芯片，耐高压芯片，系统芯片，闪存芯片，EEPROM芯片，图像传感器芯片电源管理，微型机电系统等。 | | |
| **技术需求** | **技术需求名称** | | **需求详情、技术基础及合作意向** |
| 纯CVD碳化硅机械加工工艺 | | CVD碳化硅沉积后的原材料，其本身具有的硬度大，脆性高的特点。备件边缘尺寸要求很薄（0.4mm）。在加工中，边缘处极易破损，发生断裂。需要开发出新的加工工艺，保证成品率。 |
| **预期取得的主要成果和效益** | 需要开发出纯CVD碳化硅新的加工工艺，保证成品率。  实现加工完全国产，打破国外垄断。 | | |
| **希望政府部门协调解决的问题和相关建议** | 给出高硬度材料加工工艺的指导方案，协助厂商更快地完成攻关进度。 | | |